

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-21

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	长江养老保险、华安基金、富国基金、诺德基金、中欧基金、Point72 Hong Kong Limited、 中信保诚基金、中邮创业基金、友邦人寿保险、浙商证券、东方证券、路博迈基金（中国）、 上海景领投资、上海常春藤私募基金、浙商证券、天风证券、山西证券、诺德基金、 长江养老、永赢基金、大成基金、兴业证券、高盛、东方财富证券、长江证券、西部证 券、Eastspring Invs (Singapore) Ltd、Grand Alliance Asset Mgmt Ltd、JP Morgan、 Power Sustainable Inv Mgmt、Temasek Intl Pte Ltd
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；证券事务主管：阳佩琴； 投资者关系经理：郭家旭
时间	2025 年 5 月 21 日
地点	兴业证券策略会、高盛策略会、电话及网络会议
形式	实地调研、电话及网络会议
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司近期经营情况及工厂产能利用率情况。 公司近期各项业务经营正常，综合产能利用率仍处于相对高位，其中 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率保持高位运行；封装基板业务因近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率较 2024 年第四季度、2025 年第一季度均有所提升。 Q2、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。 公司 FC-BGA 封装基板现已具备 20 层及以下产品批量生产能力，各阶产品相关送样认证工作有序进行。20 层以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。 公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡早期阶段，由此带来的成本及费用增加，对公司利润造成一定负向影响。得益于各类订单逐步投入

生产，广州封装基板项目在 2025 年第一季度亏损环比已有所收窄。

Q3、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。

公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看，公司封装基板业务主要面向 IDM 类（半导体垂直整合制造商）、Fabless 类（半导体设计商）以及 OSAT 类（半导体封测商）厂商。

Q4、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国（工厂在建）均设有工厂。一方面，公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能；另一方面，公司有序推进南通四期项目建设，构建 HDI 工艺技术平台和产能，目前正在推进项目基础工程建设。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q5、请介绍公司 PCB 产品对 HDI 技术的应用情况。

HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q6、请介绍公司泰国工厂投资规模及业务定位。

公司在泰国工厂总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设按期有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。

Q7、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年一季度，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格同比提升、较 2024 年第四季度亦出现一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无